

高可用性ソフトウェアや豊富なミドルウェアと密に連携。
フレキシブルなオープンシステムがビジネスの成長を促します。

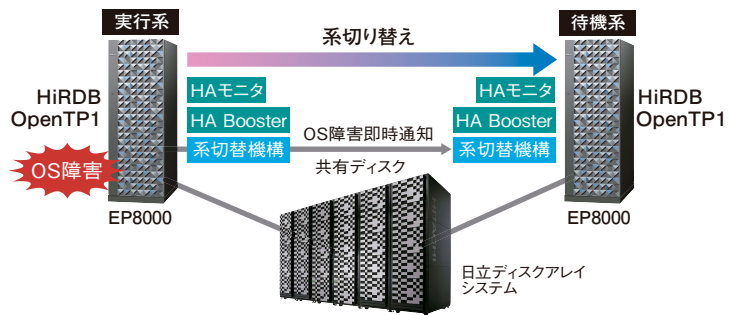
大規模、高信頼、高可用なUNIXシステムを実現

- ノンストップデータベース「HiRDB」や分散トランザクションマネージャ「OpenTP1」などの日立オープンミドルウェア、およびHAクラスタ管理ソフトウェア「HAモニタ」との連携により、クラスタシステムのホットスタンバイ方式による高速な系切り替えを実現。系切り替えとしては、自動切り替え、計画切り替え、連動切り替えの3種類を提供し、柔軟な運用が可能です。さらに、日立の独自機能として開発されたAIX®拡張機能「HA Booster Pack for AIX」と組み合わせることにより、最短で10数秒という世界最高水準の系切り替え処理の高速化を実現します。
- 高可用性ソフトウェア「PowerHA SystemMirror*」を提供し、システムとアプリケーションのフェイルオーバーが可能なクラスタ構成を支援します。また、ハードウェアの障害時における故障箇所の発見や利用可能な資源の動的再構成、障害予防、ログ機能などにより、多様な環境にも柔軟に対応することができます。

*HACMP (High Availability Clustering Multi Processing) およびPowerHA for AIXは、V6.1からPowerHA SystemMirrorに名称変更しました。

高可用なクラスタ構成

- 系切替機構を介したOS障害発生即時通知を実現。
- 共有ディスク数に依存しない安定した高速ディスク切り替え時間を確保。
- ホットスタンバイ環境における10数秒の高速な系切り替えを実現。



※本製品には、有寿命部品(HDDなど)が使用されています。長期間使用する場合には、定期的な保守による部品交換が必要になります。詳細については下記「製品情報サイト」をご覧ください。
※本製品のハードウェア保守サービス期限は、製品納入時期より5年間です。
※本製品は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービスおよび技術サポートは行っておりません。

・IBM、AIX、DataStage、HACMP、Power、POWER、POWER9、PowerHA、SystemMirrorは、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。・Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。・OracleとJavaは、Oracle Corporation及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。・SAPは、ドイツおよびその他の国々におけるSAP AGの商標または登録商標です。・UNIXは、The Open Groupの米国ならびに他の国における登録商標です。



私たちは株式会社 日立製作所 システム&サービスビジネスとして環境マネジメントシステムに関する国際規格ISO (国際標準化機構) 14001:2015の審査を受け、登録され、製品・サービスのライフサイクル全般における環境問題に積極的に取り組んでいます。
登録番号:EC02J0400 登録日:1995年7月19日
<https://www.hitachi.co.jp/it-iso14001/>

**安全に関するご注意**

ご使用の前に必ず製品添付のマニュアルなどの注意事項をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- カタログに記載の仕様は、製品の改良などのため予告なく変更することがあります。また、製品写真は出荷時のものと異なる場合があります。
- 本製品を輸出される場合には、外国為替および外国貿易法の規制ならびに米国の輸出管理規則など外国の輸出関連法規をご確認のうえ、必要な手続きをお取りください。
なお、ご不明な場合は、当社担当営業にお問い合わせください。

製品に関する詳細・お問い合わせは下記へ

- 製品情報サイト
<https://www.hitachi.co.jp/EP8000/>
- インターネットでのお問い合わせ
<https://www.hitachi.co.jp/EP8000-inq/>
- 電話でのお問い合わせはHCAセンターへ
 0120-2580-12 受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00 (土・日・祝日・当社休日を除く)

 株式会社 日立製作所 サービスプラットフォーム事業本部

エンタープライズサーバ
EP8000シリーズ

HITACHI
Inspire the Next

Linux®アプリケーションの利用、開発が可能

- LinuxアプリケーションをAIX®上に移植するためのLinux APIなど親和性の高い環境の提供により、AIX®とLinuxとの統合が可能です。
- GNU/Linuxツール、ユーティリティなどLinuxの多様なツールを活用したアプリケーション開発も可能です。

豊富なネットワーク接続環境

- OSIや日立ネットワークアーキテクチャ(HNA)環境など、各種回線への接続が可能。EP8000シリーズをフロントエンドプロセッサとして活用することにより、メインフレームの負荷分散を実現します。

主要サポートプロトコル

- OSI ●HNA (1次局、2次局) ●X.25 ●HDLC ●全銀
- JCA ●NCSB

多彩なソフトウェア製品に対応

基幹システムで実績のある日立オープンミドルウェアに加えて著名ISV製品にも対応。幅広いニーズにこたえるシステムを構築します。

ハイパベイラビリティ	HAモニタ、Hitachi HA Booster Pack for AIX、PowerHA SystemMirror
統合システム運用管理	JP1
SOA基盤/AP基盤	Cosminexus、OpenTP1、TPBroker
DBMS/周辺ソフトウェア	Oracle、HiRDB、DABroker、DBPARTNER2、DataStage®
言語	XL C for AIX、XL C/C++ for AIX、XL Fortran for AIX、COBOL2002
ユーティリティ	ISAM/SORT
開発環境	XMAP3、EUR (帳票出力製品)
文書管理	DocumentBroker

ENTERPRISE SERVER

EP8000

高性能Power®
プロセッサを搭載。

オープンプラットフォーム環境でのミッションクリティカルシステムを支えます。

637

8/16、24コア

障害対応機能を強化したファイバチャネルアダプタと専用ドライバにより、日立ディスクアレイシステムと高度に連携。膨大なデータを守り、活用し、管理するための、高性能で高信頼なシステム構築を実現します。

エントリーからハイエンドまで、ニーズに応じてお選びいただける多彩な ラインアップ

エントリーサーバ
EP8000 S914

高性能Power9搭載で、
高度な信頼性とI/O拡張性を実現。
100V電源やタワー筐体をサポートした
6コアエントリーモデル

- 高性能Power9を最大6コア搭載。
- 高速大容量メモリーを最大1TiB、HDDを最大21.6TB搭載可能。
また、I/Oスロットを13本(ラックマウント)*サポートし、PCI Express 4.0仕様にも準拠。
- 100V電源に対応。また、床置き可能なタワー筐体をサポート。

*周辺装置拡張筐体であるI/Oドロワー接続時



エントリーサーバ
EP8000 S924

高速データ転送により、
大容量データ処理に威力を発揮。
クラス最高水準の性能と信頼性に優れた
24コアエントリーモデル

- 高性能Power9を最大24コア搭載。エントリークラスでは最高水準の性能を発揮。
- 高速大容量メモリーを最大4TiB、HDDを最大21.6TB搭載可能。また、I/Oスロットを26本*サポートし、PCI Express 4.0仕様にも準拠。
- 電源は2+2の冗長構成。1台の電源に障害が発生しても、冗長構成の維持が可能。

*周辺装置拡張筐体であるI/Oドロワー接続時



ハイエンドサーバ
EP8000 E980

高性能プロセッサを搭載し、
優れた処理性能と柔軟な拡張性を備えた
ハイエンドモデル

- 高性能Power9を搭載。コア単体性能に加え、高いスケーラビリティを発揮。
- プロセッサは最大192コア、メモリーは最大64TiBまで搭載可能。
また、CUoD機能をサポートし、段階的なリソース増強を稼働時に実施可能。さらに、I/OスロットはPCI Express 4.0仕様に準拠し、最大192本*と高スベック・高拡張性を実現。
- 高信頼・高可用・高保守性に磨きをかけ、二重化構成、動的フェイルオーバー、活線交換機能などが充実。

CUoD:Capacity Upgrade on Demand
*周辺装置拡張筐体であるI/Oドロワー接続時



ハイエンドサーバ
EP8000 E1080

最新鋭プロセッサを搭載し、
処理性能向上とセキュリティ機能強化を実現。
環境にも配慮したハイエンドモデル

- 最新鋭Power10を搭載。メモリー暗号化を高速に行う機能をサポート。
投機的実行に関する脆弱性への攻撃を緩和する機能を高速化し、将来のセキュリティ脅威に備える耐量子暗号にも対応可能。処理性能向上と消費電力低減により、プロセッサのコアあたりのエネルギー効率を約2.6倍*1に向上させ環境に配慮。
- プロセッサは最大160コア、メモリーは最大64TiBまで搭載可能。
I/OスロットはPCI Express 5.0仕様に準拠し、最大192本*2。
- CUoD機能、二重化構成、動的フェイルオーバー、活線交換機能など従来モデル(E980)の特長機能、高信頼・高可用・高保守性を継承。

*1 Power9との比較 *2 周辺装置拡張筐体であるI/Oドロワー接続時



ハードウェア基本仕様

モデル		S914	S924
形状		タワー/ラックマウント	ラックマウント
プロセッサ	名称	Power9	Power9
	クロック・レート	2.3GHz(max 3.8GHz)	3.8GHz(max 4.0GHz)
	プロセッサ数	6コア	8/16コア
	レベル1キャッシュ*1	命令64KiB + データ64KiB(1コアあたり)	命令64KiB + データ64KiB(1コアあたり)
	レベル2キャッシュ*1	512KiB(1コアあたり)	512KiB(1コアあたり)
メモリー容量	最小~最大*1	10MiB(1コアあたり)	10MiB(1コアあたり)
	レベル3キャッシュ*1	32GiB~1,024GiB	32GiB~4,096GiB
ディスク容量	最小~最大*2	300GB~21.6TB	300GB~21.6TB
拡張PCIスロット本数(最大)		タワー:PCI Express 4.0(x16):3 PCI Express 4.0(x8):5*3 ラックマウント:PCI Express 4.0(x16):3*4 PCI Express 4.0(x8):5*3 PCI Express 3.0(x16):2*5 PCI Express 3.0(x8):4*5	PCI Express 4.0(x16):5*6 PCI Express 4.0(x8):6*3 PCI Express 3.0(x16):6*7 PCI Express 3.0(x8):12*7
外形寸法(W×D×H)		タワー: 328.5×814.7×486.1mm ラックマウント: 482×769.6×173.3mm(4U*8)	482×769.6×173.3mm(4U*8)
電源仕様	電圧	タワー:100~127V(単相) ラックマウント:100~127V/200~240V(単相)	200~240V(単相)
	周波数	50または60Hz	50または60Hz
環境仕様	温度条件	5~40℃	5~40℃
	湿度条件(結露不可)	8~80%	8~80%
質量(最大)		タワー: 46.94kg ラックマウント: 36.3kg	39.9kg
消費電力	運用時	1.6kW	2.75kW
	最大	1.6kW	2.75kW
省エネ法に基づく表示(2021年度基準)	区分	7	8
	エネルギー消費効率*9	7.6	9.8

*1 1KiB=1,024バイト、1MiB=1,024²バイト、1GiB=1,024³バイト、1TiB=1,024⁴バイトとして計算した数値です。*2 1GB=1,000³バイト、1TB=1,000⁴バイトとして計算した数値です。*3 PCIスロットは標準Ethernetアダプタ搭載用に1スロット消費します。*4 I/Oドロワー1台接続時にPCIスロットを1スロット消費します。*5 I/Oドロワー1台接続時の数値です。*6 I/Oドロワー1台接続時にPCIスロットを1または2スロット、I/Oドロワー2台接続時に3スロット消費します。*7 I/Oドロワー2台接続時の数値です。*8 ラック搭載時の占有サイズ(1U: 44.45mm)。*9 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。

ハードウェア基本仕様

モデル		E980	E1080
形状		ラックマウント	ラックマウント
プロセッサ	名称	Power9	Power10
	クロック・レート	3.9GHz(max 4.0GHz)	3.65GHz(max 3.90GHz)
	プロセッサ数	8~128コア	12~192コア
	レベル1キャッシュ*1	命令64KiB + データ64KiB(1コアあたり)	命令96KiB + データ64KiB(1コアあたり)
	レベル2キャッシュ*1	512KiB(1コアあたり)	2MiB(1コアあたり)
メモリー容量	最小~最大*1	10MiB(1コアあたり)	8MiB(1コアあたり)
	レベル3キャッシュ*1	256GiB~65,536GiB*2	512GiB~65,536GiB*2
ディスク容量	最小~最大*3	0GB~12,800GB*2	0GB~12,800GB*2
拡張PCIスロット本数(最大)		PCI Express 4.0(x16):32*2*4*5 PCI Express 3.0(x16):64*4*6 PCI Express 3.0(x8):128*4*6	PCI Express 5.0(x8)/PCI Express 4.0(x16):24*2*4*5 PCI Express 5.0(x8):8*2*4*5 PCI Express 3.0(x16):64*4*6 PCI Express 3.0(x8):128*4*6
外形寸法(W×D×H)		システムコントロールユニット:445.6×779.7×86mm(2U*7) サーバ筐体:445.5×867×218mm(5U*7)	システムコントロールユニット:445.6×779.7×86mm(2U*7) サーバ筐体:445×866.95×217.25mm(5U*7)
電源仕様	電圧	200~240V(単相)	200~240V(単相)
	周波数	50または60Hz	50または60Hz
環境仕様	温度条件	10~35℃	5~40℃
	湿度条件(結露不可)	8~80%	8~85%
質量(最大)		システムコントロールユニット:22.7kg サーバ筐体:86.2kg*8	システムコントロールユニット:22.7kg サーバ筐体:81.6kg*8
消費電力	運用時	4.13kW*8	4.5kW*8
	最大	4.13kW*8	4.5kW*8
省エネ法に基づく表示(2021年度基準)	区分	対象外	対象外
	エネルギー消費効率*9	対象外	対象外

*1 1KiB=1,024バイト、1MiB=1,024²バイト、1GiB=1,024³バイト、1TiB=1,024⁴バイトとして計算した数値です。*2 CPUドロワー4台接続時の数値です。*3 1GB=1,000³バイト、1TB=1,000⁴バイトとして計算した数値です。*4 PCIスロットは標準Ethernetアダプタ搭載用に1スロット消費します。*5 I/Oドロワー1台接続ごとにPCIスロットを1または2スロット消費します。*6 I/Oドロワー16台接続時の数値です。*7 ラック搭載時の占有サイズ(1U: 44.45mm)。*8 CPUドロワー1台あたりの数値です。*9 エネルギー消費効率とは、中央演算処理装置、補助記憶装置及び主記憶装置の消費電力あたりの性能を幾何平均して得られる数値です。